



Investor Relations 2025

Disclaimer



본 자료는 주주 및 기관투자자들을 대상으로 실시되는 프레젠테이션에서의 정보 제공을 목적으로 **예스티**(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다. 본 프레젠테이션의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다.

이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’ ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다. 예측정보는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있고, 회사는 이에 대한 업데이트 책임을 지지 않습니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않고 어떠한 경우에도 민·형사상의 분쟁 및 다툼에 있어 증거 자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Table of Contents



I.	Corporate Identity	04
II.	Company Overview.....	06
III.	Business Overview.....	11
IV.	Strength & Opportunity.....	16
V.	Growth Strategy.....	20
VI.	APPENDIX.....	24



1. Corporate Identity

1. Corporate Identity

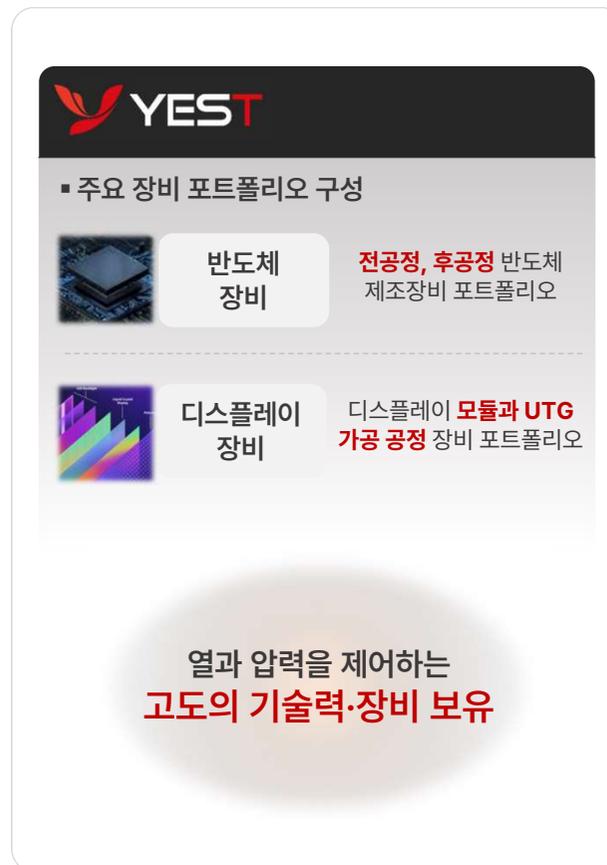


온도와 압력 제어 기술을 바탕으로 반도체와 디스플레이 장비를 제조
"지속적인 R&D를 통해 반도체 장비의 다양화와 글로벌 확장을 통해 성장"

핵심역량

주요제품

성장전략





2. Company Overview

2. Company Overview - 회사개요



Industry 전문가로 구성된 탄탄한 리더십 보유
“반도체와 디스플레이 사업 전문인력으로 구성”

회사개요

회사명	주식회사 예스티
대표이사	장동복, 강임수
설립일	2000년 03월 06일
자본금	10,717백만원 ('25년 06월말 기준)
임직원수	186명 ('24년 12월말 기준)
사업분야	반도체 및 디스플레이 장비 제조
본사	경기도 평택시 진위면 마산12로 27
홈페이지	https:// www.yest.co.kr



경영진



장동복 Chairman / Co-CEO

현 예스티 공동 대표이사
 전 케이씨텍 기술영업
 전 세종반도체 기술영업

강임수 Co-CEO

현 예스티 공동 대표이사
 전 삼성전자 DDI 설계그룹장
 전 삼성전자 전략마케팅팀장
 전 삼성전자 LSI 개발실장



최승하 Vice Chairman

현 예스티 부회장
 전 삼성디스플레이 부사장
 전 삼성전자 전략지원 TF 담당임원

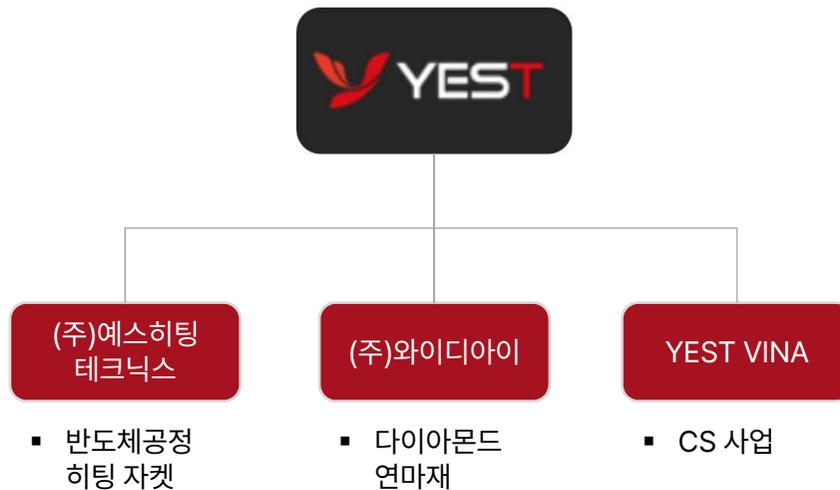
2. Company Overview - 조직 및 주주구성



반도체 공정 중심의 사업확장을 위한 조직 구성
"경영권을 안정적으로 확보하기 위한 지분구조 보유"

조직도

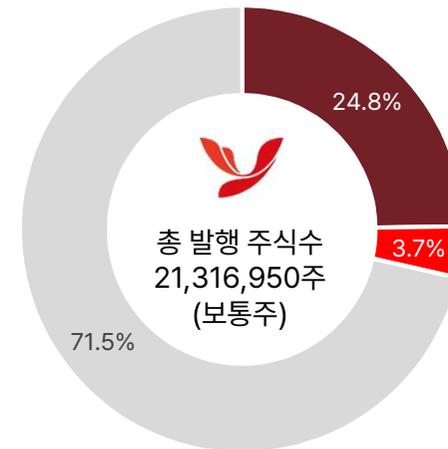
(기준일 : 2024년 12월말)



* 상기 외 2개의 신기술사업투자조합을 연결대상 종속회사로 보유

주주구성

(기준일 : 2025년 06월말)



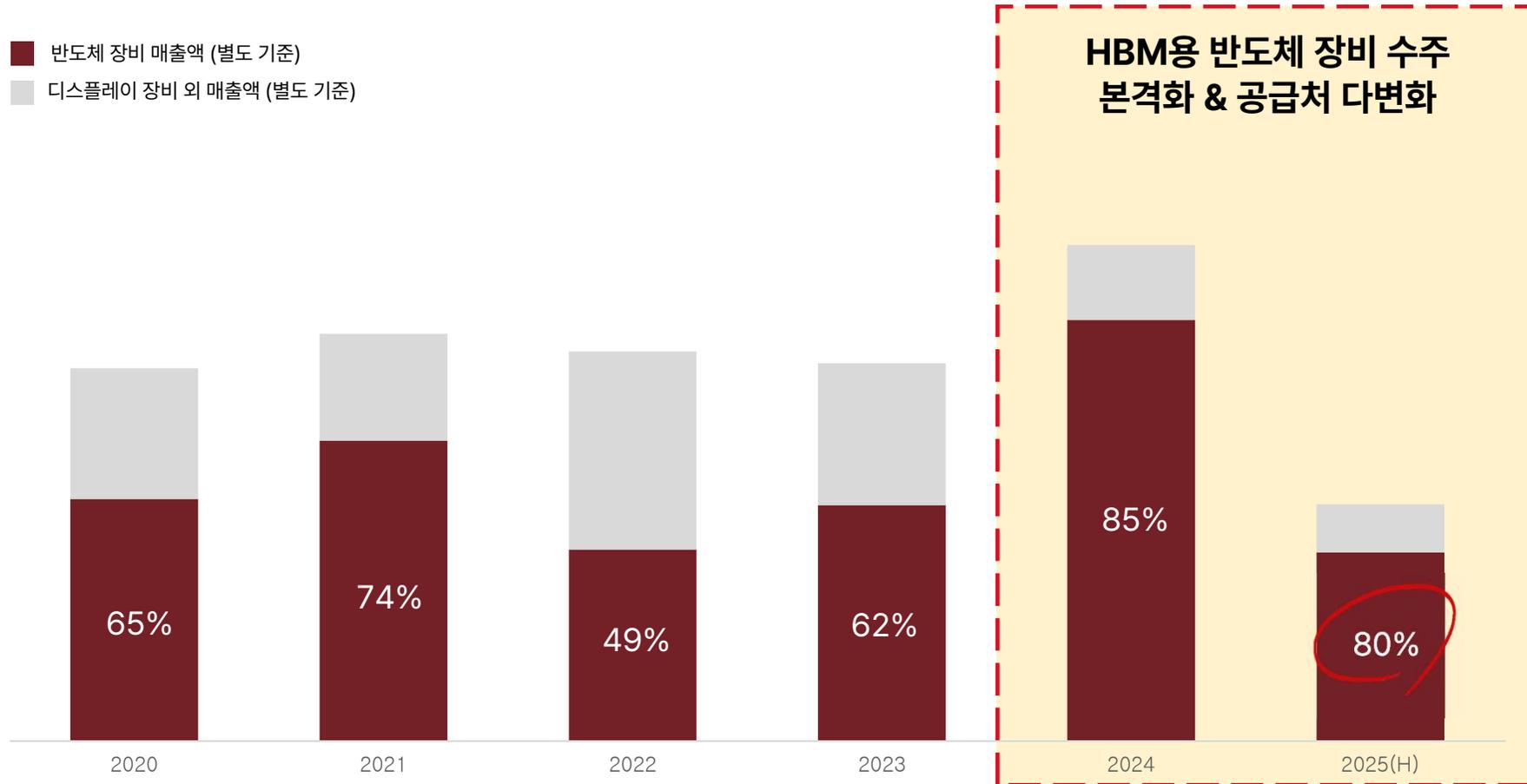
- 장동복 (Founder) 외 특수관계인 : 24.8%
- 자사주 : 3.7%
- 기타 : 71.5%

2. Company Overview - 성장 연혁



반도체와 디스플레이 산업 빅사이클에 맞춰 성장
"AI 시대 HBM 高성장 빅사이클에 맞춰 성장 본격화"

- 반도체 장비 매출액 (별도 기준)
- 디스플레이 장비 외 매출액 (별도 기준)



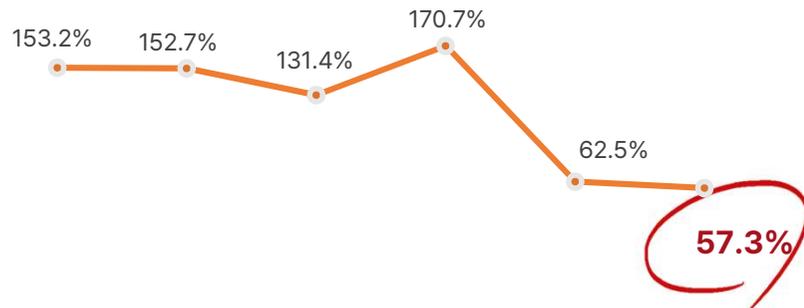
2. Company Overview – Financial Snapshot



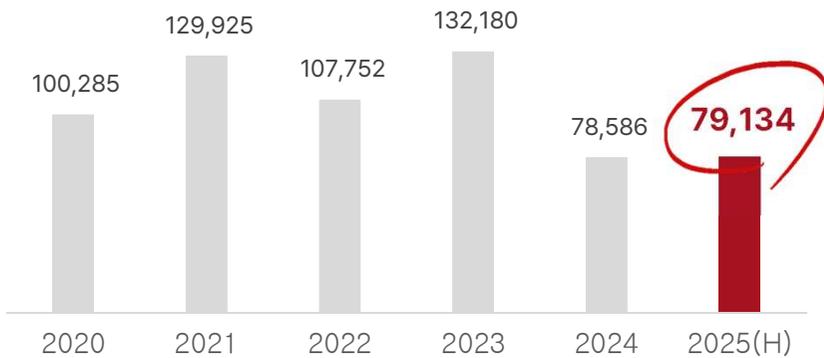
高마진 장비 중심으로의 체질 개선 진행
"분기별 영업이익률이 획기적으로 개선"

재무 안정성 지표 ('21 ~ '25(H))

- 연결 총부채비율



- 연결 총부채



분기별 영업실적 (Q1 '24 ~ Q2 '25)

- 연결 영업이익률



- 연결 매출액





3. Business Overview

3. Business Overview - 사업운영현황



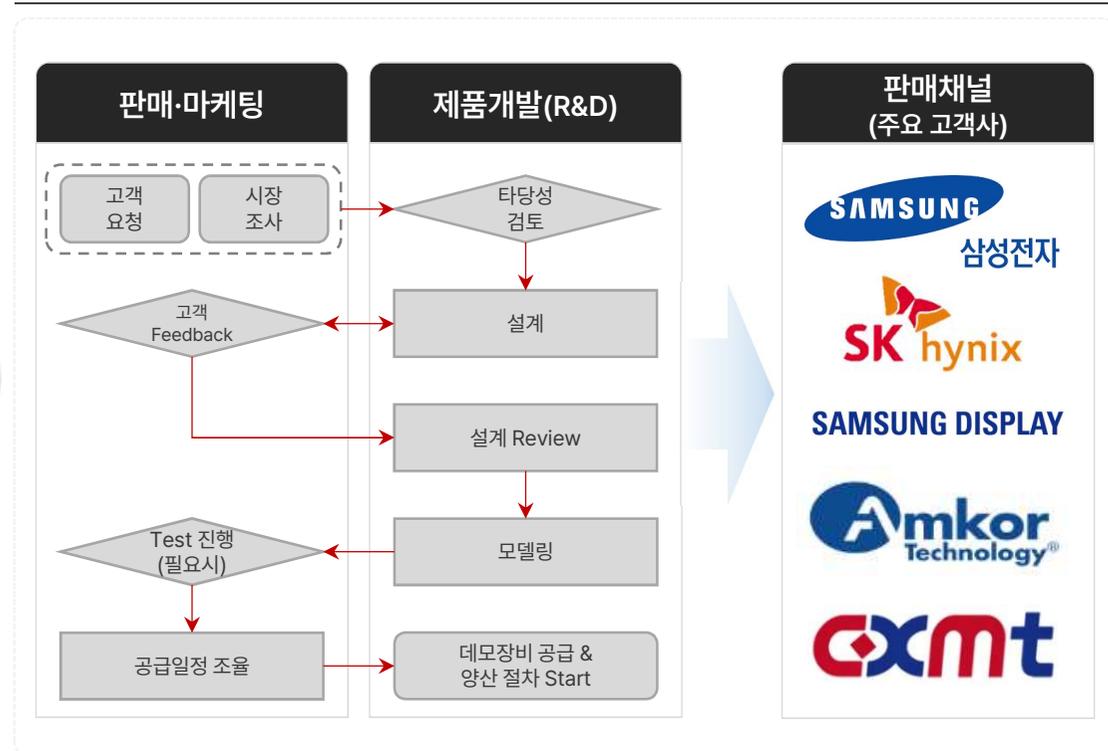
예스티는 반도체·디스플레이 장비 사업을 영위
 “R&D 기술역량을 바탕으로 국내외 유수의 글로벌 고객사와 비즈니스 이행”

Business Structure

사업부문의 개요

사업 부문	반도체 장비 사업부문
사업 영역	반도체 표면을 개선하고 수율을 향상시키는 장비 개발 등
고객	삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기, 원익 QnC, AMKOR, CXMT 등
사업 부문	디스플레이 장비 사업부문
사업 영역	Filler 및 flim 기포를 제거, glass 합착을 위한 장비 개발 등
고객	삼성디스플레이, 세경하이테크, UTI, 파인애플, 도우인시스 등

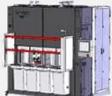
Biz Flow



3. Business Overview - 제품 포트폴리오



예스티 보유 반도체·디스플레이 장비 포트폴리오

기존·신규 장비 글로벌 기업 지속 공급	반도체 장비					디스플레이 장비				
	Furnace					NEOCON	Autoclave			
	 e-Furnace	 Vacuum	 Diffusion	 p-Furnace	 High Pressure D2 Anneal Furnace	 NEOCON	 TV Panel	 Mobile	 VDO	
	Chiller		Autoclave			PCO	Lamination			
 Single & Dual Chiller		 Cryochiller	 Wafer	 Autoclave	 PCO	 Main Lami	 Film Auto Lami	 Slit Lami		

3. Business Overview - 주요제품 (반도체 장비)



Wafer의 수율을 향상시키는 후공정 장비에 특화
 “반도체 후공정에서 전공정으로 점진적 확대”



* 예스티 주요 반도체 장비

	고압 어닐링 장비(HPA)	Neocon	퍼니스 / 칠러 장비	가압 큐어 장비
적용 공정	<ul style="list-style-type: none"> 산화, 증착 공정 등 (Deposition-확산) 	<ul style="list-style-type: none"> 전공정 전반 (EFEM 장비 습도 제어) 	<ul style="list-style-type: none"> EDS 공정 (Wafer Test-자동선별) 	<ul style="list-style-type: none"> 패키징 공정 (Die-접착필름)
시장 진입	<ul style="list-style-type: none"> Qualification 단계 	<ul style="list-style-type: none"> 양산 단계 	<ul style="list-style-type: none"> 양산 단계 	<ul style="list-style-type: none"> 양산 단계
기능	<ul style="list-style-type: none"> 고압으로 수소(H₂), 중수소(D₂)를 계면 결함 발생한 곳에 침투시켜 화학적 반응으로 치유 	<ul style="list-style-type: none"> 반도체 공정설비 내부를 습도 10% 미만으로 제어하여 Wafer 수율 향상 	<ul style="list-style-type: none"> 퍼니스 : Wafer 이물질 제거 & 이온 안정화 칠러 : Wafer Test - 초저온 제어 	<ul style="list-style-type: none"> HBM 언더필 공정에 활용 (보이드 제거 및 경화)

3. Business Overview - 주요제품 (디스플레이 장비)



다양한 디스플레이 공정 장비 라인업을 보유
 “특히 OLED·Flexible 디스플레이 공정에 특화”

OLED 공정



디스플레이
공정 장비
일원화

예스티 주요 디스플레이 장비

장비명	적용 공정	기능
Autoclave 	- 모듈 공정 (OLED, Flexible)	압력을 가해 Filler 및 Film의 기포 제거 등
라미네이션 장비 	- 봉지 공정 (OLED, Flexible)	Glass에 충격 보호 필름 합착 등
자외선 경화 장비 	- 봉지 공정 (OLED, Flexible)	Glass와 패널의 접착 과정에서 극자외선 조사, 밀폐제 강화
UTG 장비 	- 라미네이션 - 열처리 강화 - 기포 제거 공정	합착, 화학적 강화, 제품 품질향상 등



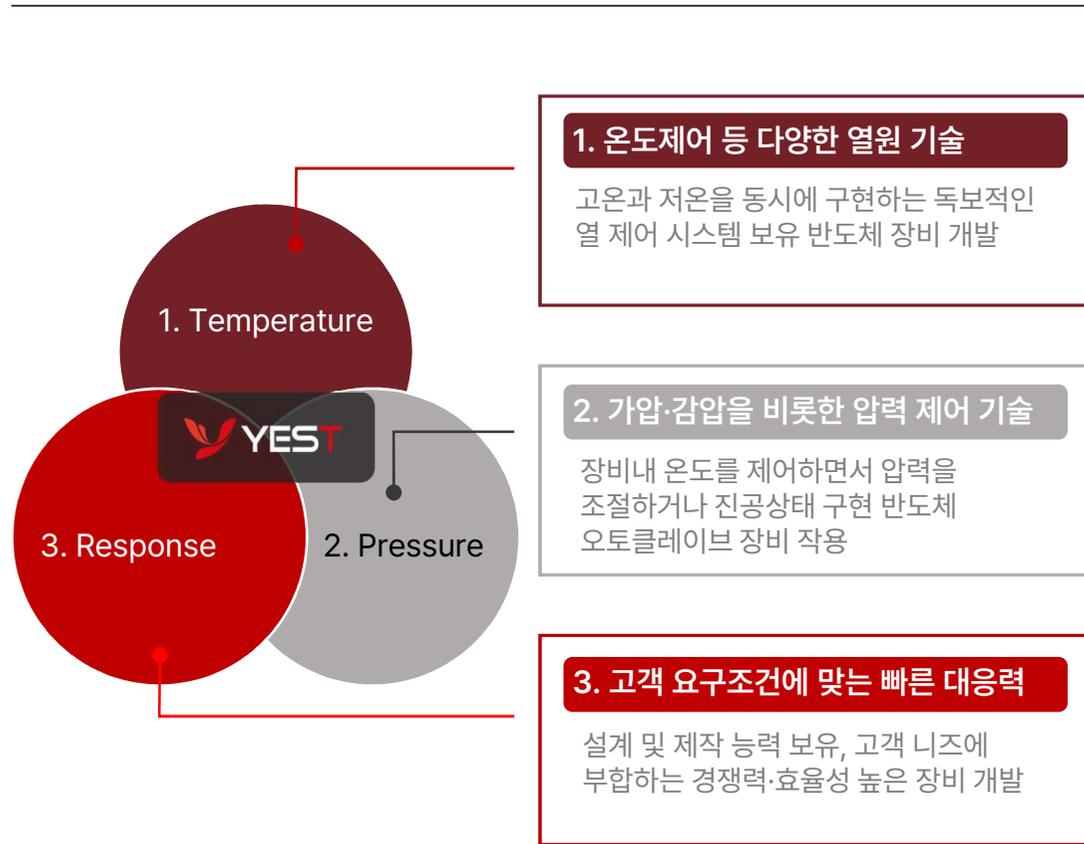
4. Strength & Opportunity

4. Strength & Opportunity - 핵심역량



예스티 고유의 R&D 역량을 바탕으로 중장기적 성장계획 확립
"20년 이상의 열·압력 제어 기술 역량을 바탕으로 시장 선도"

핵심역량



Growth Driver

✓ 열과 압력을 제어하는 고도의 기술력·장비 필요성 증가

- ✓ ('23~)HBM이 점차 고도화됨에 따라 '언더필' 공정 개선을 통한 반도체 성능보호 必

단·중기 Opportunity

- ✓ ('25~) 고압 어닐링 장비(HPA)의 사용처 확대 (Foundry → Memory)

중·장기 Aspiration

4. Strength & Opportunity - Opportunity

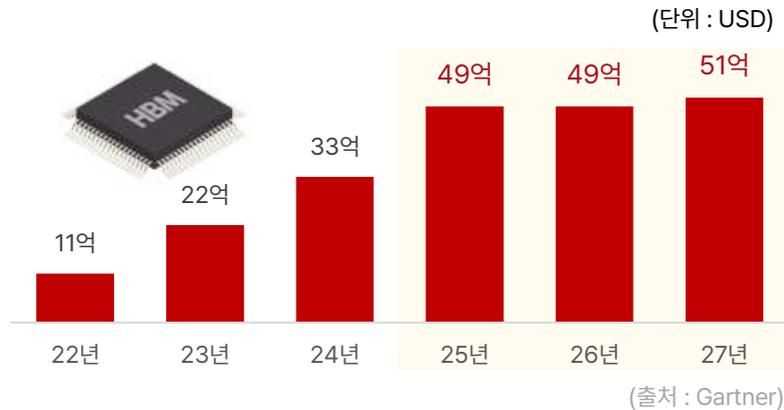


반도체 시장을 주도하는 HBM

“에스티는 지속적인 HBM 장비 고도화를 통해 공급 확대 목표”

HBM 시장전망

HBM 시장 규모 전망



HBM 양산 로드맵

	SK하이닉스	삼성전자	마이크론
2024년	HBM3E	HBM3E	HBM3E
2025년	HBM4 (목표)		
2026년		HBM4 (목표)	HBM4 (목표)

(출처 : 각사 HBM 양산 로드맵)

에스티 HBM 장비 고도화 및 공급 확대

기존 공급 장비 활용

- 차세대 HBM용 가압 장비 개발 및 업그레이드 진행 (Wafer 가압 Size 축소를 통한 footprint 개선 등)
- 차세대 DRAM용 Furnace 장비 개발 및 업그레이드 진행 (저온대역 대응 및 uniformity 개선 등)

신규 장비 개발 및 수주 대응

- Hybrid bonding용 VF300 (vacuum furnace)
- HBM용 Probe 칠러 수주대응

4. Strength & Opportunity - Opportunity



HBM 가압장비 독점 공급사인 예스티 "HBM 투자 수혜 기대"

HBM 가압장비 개발 레퍼런스 ('11~)

- 2011**
 - 국책과제 기반 원천기술 확보, 300mm 가압장비 개발
- 2014**
 - 국내 최초·업계 유일 사각 챔버 가압장비 개발, 현재까지 독점공급 중
- 2015**
 - WLP, PLP 등 다양한 패키징 공정에 중요 장비로 적용 시작
- 2016**
 - 웨이퍼 무게 및 뒤틀림 방지 등 기존 장비 고도화로 시장 점유율 확대
- 2021**
 - 400mm 사각 챔버 및 Side Buffer Station 탑재 설비 등 SIP 패키징 공정에 필요한 장비 지속 개발

HBM 가압장비 수주 레퍼런스 ('23~)



74.93억 ('23.10)	HBM 제조용 웨이퍼 가압장비 공급계약 체결	SEC향 (최초 물량 수주)
48.99억 ('23.11)	HBM 제조용 EDS Chiller 공급계약 체결	SEC향 (포트폴리오 다변화)
123.1억 ('23.11)	HBM 제조용 웨이퍼 가압장비 공급계약 체결	SEC향 (2차 물량 수주)
74.86억 ('23.12)	HBM 제조용 웨이퍼 가압장비 공급계약 체결	
59.91억 ('24.06)	HBM 제조용 웨이퍼 가압장비 공급계약 체결	SEC향 (3차 물량 수주)
45.75억 ('24.07)	HBM 제조용 웨이퍼 가압장비 공급계약 체결	HYNIX향 (공급처 다변화)
15.5억 ('24.08)	HBM 제조용 EDS Chiller 장비 공급계약 체결	
111.6억 ('24.11)	HBM 제조용 EDS 퍼니스 장비 공급계약 체결	HYNIX향 (포트폴리오 다변화)



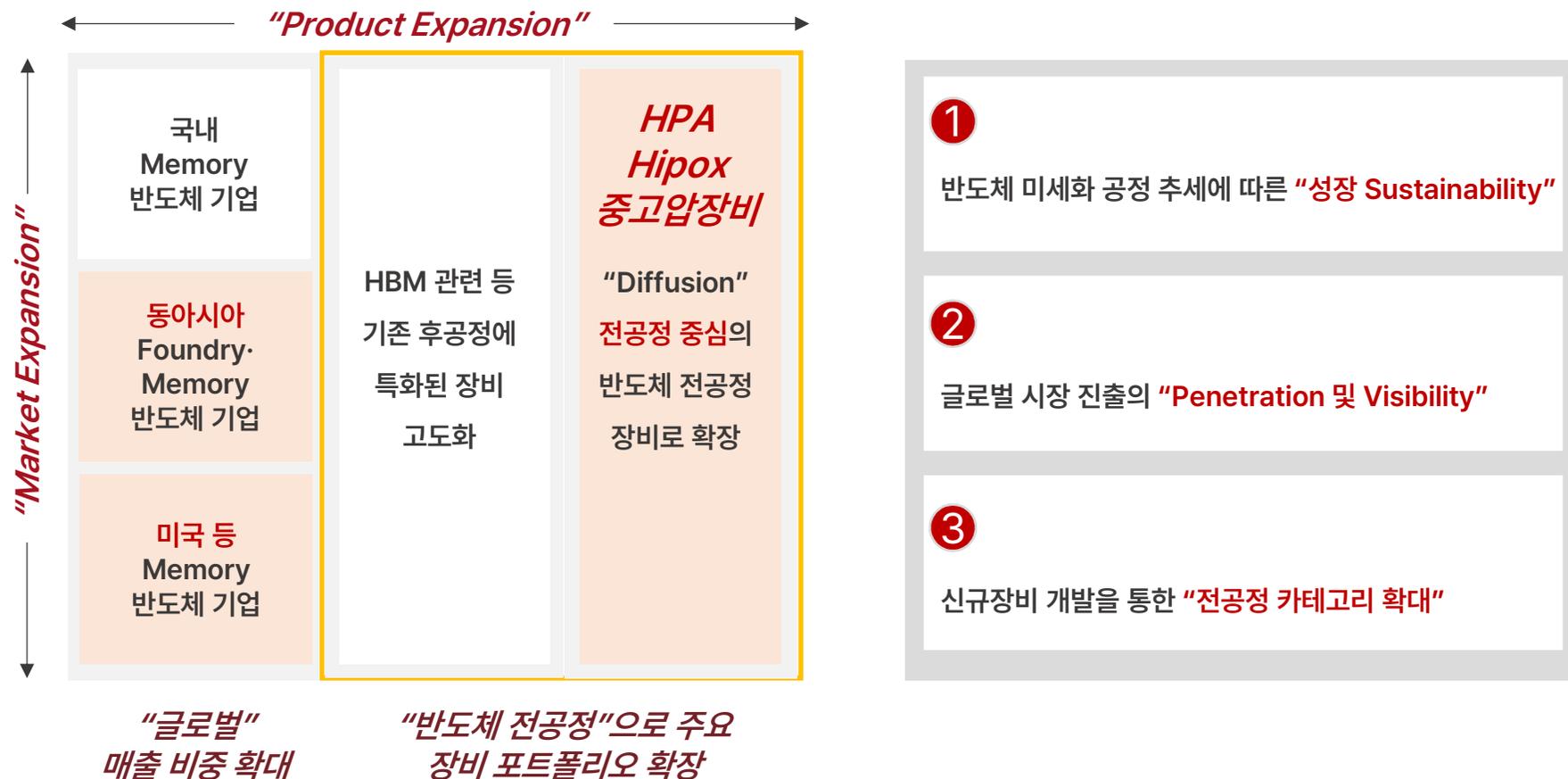
5. Growth Strategy

5. Growth Strategy - 중·장기 Aspiration



제품과 지역적 확장을 통한 비즈니스 성장을 목표

비즈니스 확장 전략

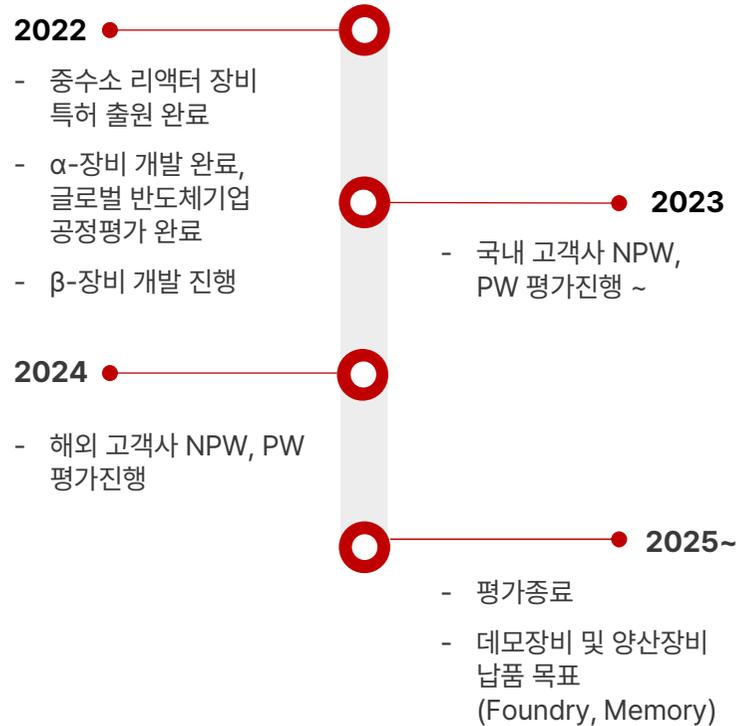


5. Growth Strategy – Product Expansion

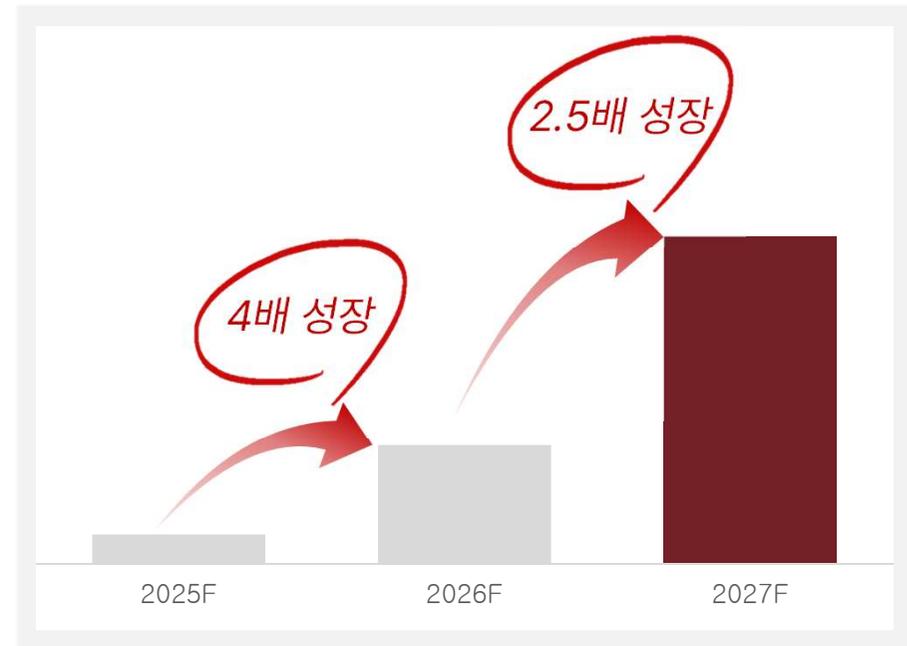


HPA 고압 어닐링 장비는 제품 확장의 Key Product "2027년까지 폭발적인 매출성장 목표"

고압 어닐링 장비 (HPA) 개발·사업현황



고압 어닐링 장비 (HPA) Sales Aspiration



2025~2027년
퀀텀 성장 목표

5. Growth Strategy – Global Expansion



Global Expansion Road-map "2025년부터 본격적인 글로벌 확장 추진"





YEST
Appendix

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

	2025(H)	2024	2023	2022
유동자산	69,341	70,625	80,258	44,521
비유동자산	134,548	133,762	129,343	145,219
자산총계	203,889	204,387	209,601	189,740
유동부채	51,637	52,811	99,847	71,928
비유동부채	22,641	25,775	32,334	35,823
부채총계	74,278	78,586	132,180	107,752
자본금	10,658	10,465	9,522	9,026
자본잉여금	114,475	108,424	86,304	65,888
기타자본항목	(6,076)	(6,363)	(6,792)	(6,996)
기타포괄손익누계액	(2,025)	(2,152)	(921)	(893)
이익잉여금	10,470	12,688	(12,686)	13,894
비지배지분	2,109	2,738	1,994	1,040
자본총계	129,611	125,800	77,421	81,989

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

	2025(H)	2024	2023	2022
매출액	48,852	100,095	79,808	75,994
매출원가	35,684	73,453	65,590	70,842
매출총이익	13,167	26,642	14,218	5,152
판매비와관리비등	8,102	15,380	14,629	22,034
영업이익	5,065	11,262	(411)	(16,882)
기타수익등	1,815	13,541	10,638	22,184
기타비용등	8,593	13,515	40,722	12,849
관계기업투자손익	(306)	1,112	561	231
법인세비용차감전계속사업이익	(2,019)	12,400	(29,934)	(7,316)
순이익	827	11,214	(28,720)	(5,230)

반도체 신뢰성 및 집적회로 성능 향상 가능한 고압 어닐링 장비 국산화

고압 어닐링 장비 개요

Hydrogen passivation

Dangling Bond

반도체 Si 표면 결함을
고압 수소·중수소로 치환

Hydrogen passivation

예스티 고압 어닐링 장비 특징

고압 어닐링
장비 국산화

중수소 리액터 장치
관련 특허 출원 완료

리드타임 축소 & 가격경쟁력 극대화

30 가압
고압처리 가능

100%
중수소 농도 유지

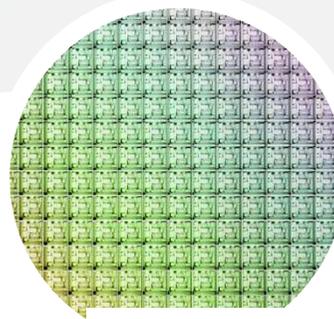
신뢰성 향상

+

회로 성능 ↑

계면결함
Dangling Bond

반도체 산화공정에서 계면의 산소와
공유결합을 하지 못한 Si가 발생



Wafer

계면의 접합부분에 빈자리가 생겨
터널링으로 인한 누설 전류 발생

반도체 신뢰성 및 집적회로 성능 향상 가능한 고압 어닐링 장비 국산화

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
파운드리						
SAMSUNG	10nm	7nm		3nm		2nm
tsmc	7nm	5nm		3nm		2nm
intel	7nm			5nm	3nm	2nm
메모리						
SAMSUNG	1Y		1Z	1A		1B
SK hynix	1Y	1Z		1A	1B	

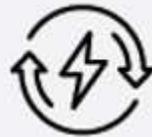
반도체 공정 미세화 장점

반도체 칩 생산량



Wafer 1개당 생산 가능 칩 개수 ↑
반도체 생산 효율성 증대

성능·전력효율



회로 내 저항 감소
발열량 감소 및 전력효율 상승

고압 어닐링 장비의 필요성



반도체 공정이 미세화 됨에 따라 MOSFET 소자에서
기존과 달리 동작하는 열화 현상을 개선



16nm 이하 미세 공정에서 고온 장비 적용 불가,
제한 온도 내에서 적용 가능한 고압 어닐링 장비 필요성 ↑

